

精密自動加熱サーボプレス機

商品番号: KT-SF



前書き

要求の厳しい材料試験用に設計されたこの高精度自動加熱サーボプレスは、最大1トンのクローズドループ加圧制御、最高300℃に達する独立したデュアルプラテン加熱、循環水冷却、および研究室向けのプログラマブルタッチスクリーン自動化を提供します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主なメリット
全固体電池の組み立て	制御された力の下での、固体電解質膜、リチウム金属箔、および複合カソード層の高精度熱統合。	界面のボイド形成を排除し、均一な低トン数圧縮と加熱によりイオン導電性を最適化します。
薄膜ポリマーマニネート	均一な熱浸漬を備えた、最大300℃までの多層熱可塑性樹脂、フッ素樹脂、およびポリイミドフィルムの熱融着と圧縮。	マイクロフォースサーボの降下と正確なプラテンの平行性により、空気の巻き込みと表面のシワを防ぎます。
ホットエンボス&マイクロレプリケーション	マイクロ流体チャネル、光学微細構造、および微細テクスチャの、環状オレフィンコポリマーおよびPMMA基板へのインプリント。	高い変位の再現性とプログラマブルな保持サイクルにより、基板の割れなしにサブミクロンのフィーチャ忠実度が確保されます。
複合材料試料の作製	機械的特性評価のための、繊維強化ポリマーテストクーポン、プリプレグ積層板、および先端プリフォームの硬化と統合。	デュアルプレート独立ランピングにより、樹脂の絞り出しを防ぎながら、完全な熱マトリックス架橋を加速します。
半導体ダイアンダーフィル & カプセル化	先端電子パッケージング基板、サーマルインターフェイス材料 (TIM)、およびアンダーフィル樹脂の熱硬化とホットプレスレベリング。	正確な±1kgの圧力調整により、脆弱なシリコンダイ、マイクロパンプ、ワイヤーボンドを機械的衝撃から保護します。
機能性セラミックグリーンボディの成形	特殊な圧電、誘電体、および構造用セラミック粉末の、均一な成形体への低トン数一軸加熱成形。	圧力の急上昇なしに一貫したグリーンボディ密度分布を実現し、焼結の歪みと層間剥離を軽減します。
実験室用XRF&FTIRペレット作製	分析分光法のための、脆弱な粉末混合物、バインダー材料、およびポリマーブレンドの成形と熱統合。	クリーンなオイルフリー動作により分光学的汚染が防止され、プログラマブルな荷重により再現性の高い光学ディスクが得られます。

パラメータ	技術仕様
装置型式	KT-SF
作業圧力範囲	0～1トン（サーボモーター駆動加圧）
圧力制御精度	±1 kg
圧力制御モード	完全にプログラム可能な圧力および保持時間制御
プラテン作業温度範囲	室温～300 °C
加熱制御アーキテクチャ	ランプ付きダブルプレート独立プログラム制御
加熱電力	1500 W
プラテン寸法	150 mm × 150 mm
最大プラテンクリアランス距離	50 mm

パラメータ	技術仕様
プラチナ冷却方法	内蔵循環水冷却
オペレーターインターフェース&コントローラー	7インチ産業用タッチスクリーンコントローラー
主電源要件	AC 220 V / 60 Hz
コンプライアンスおよび安全認証	CEマーク取得
機械式作動タイプ	クリーンな電気機械式サーボ駆動スクリュウ機構
フレームエンクロージャ構成	前面保護バリア付きベンチトップ自立型ユニット